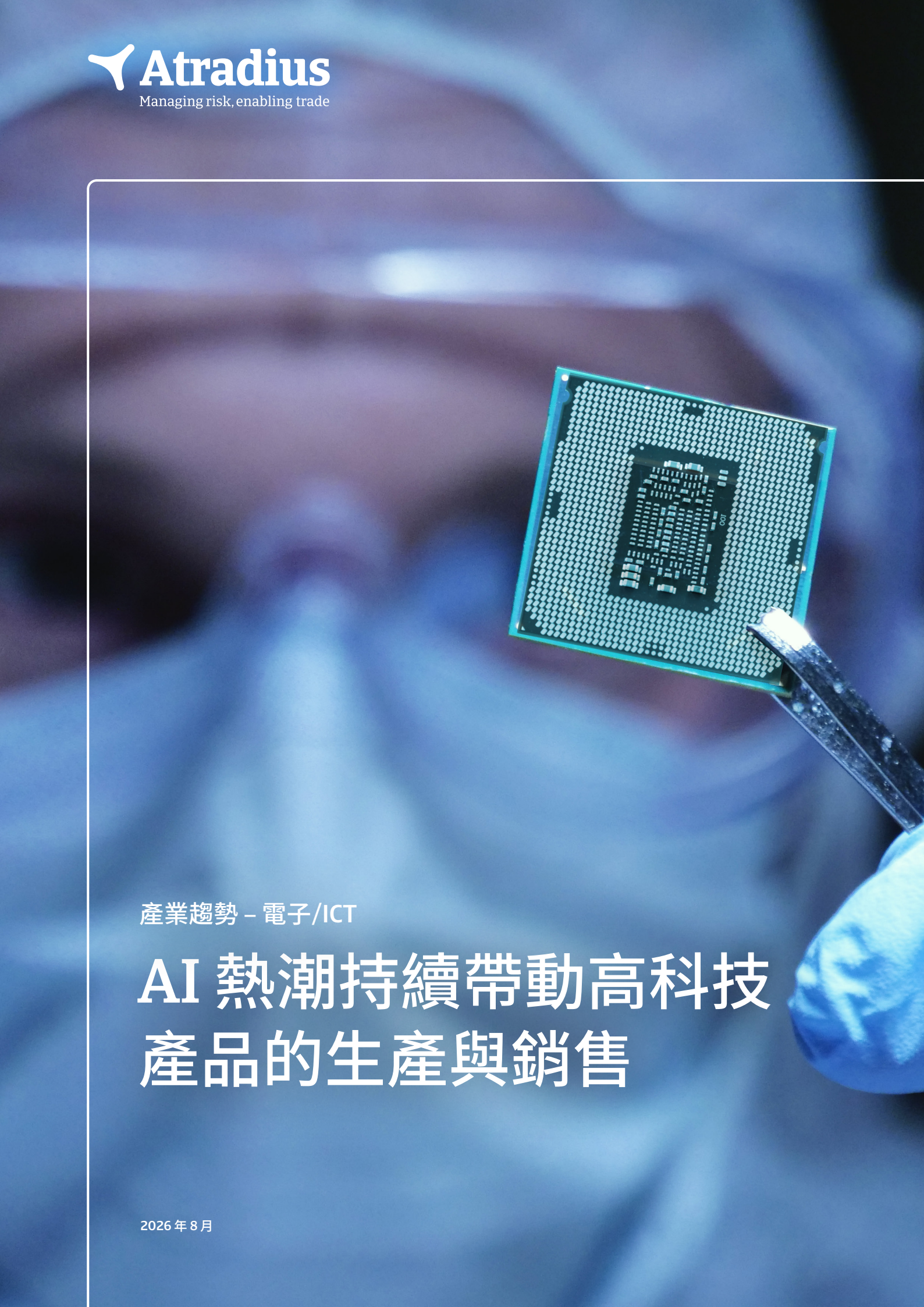
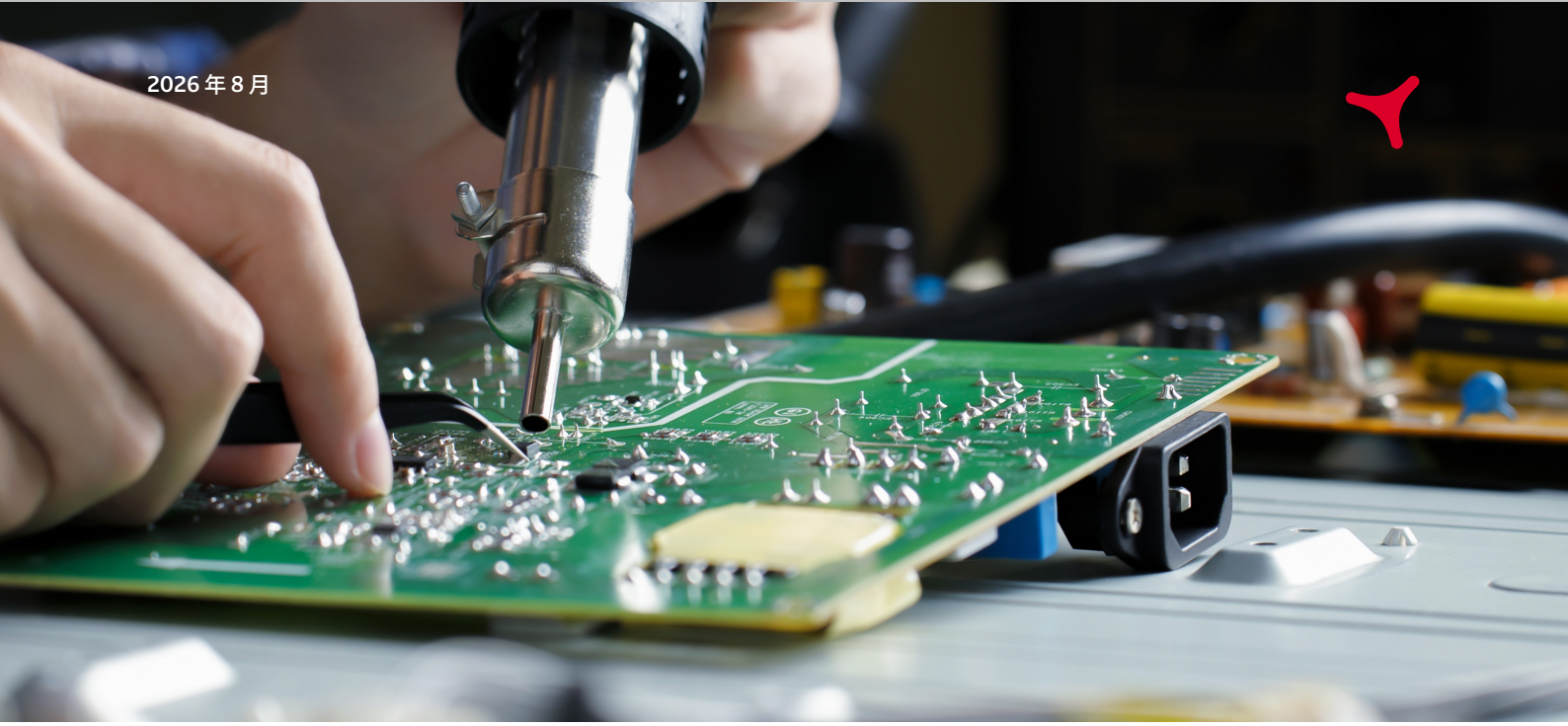
Atradius
Managing risk, enabling trade



產業趨勢 – 電子/ICT

AI 熱潮持續帶動高科技產品的生產與銷售

2026 年 8 月



全球概覽

成長率持續強勁，但記憶體晶片短缺成為供應鏈的一大問題

我們預期全球電子/ICT 產值在 2025 年增長 10% 後，2026 年將成長 11%，2027 年則成長 7.3%。投資 AI 資料中心依然是主要動能，因為對這項技術的高度期待，加上其地緣政治的重要性，促使企業進行大規模投資。2025 年全球 AI 支出約為 1.7 兆美元，主要集中在美國。預計 2026 年將增加至 2.6 兆美元，2027 年則增加至 3.5 兆美元。科技投資的強勁表現尤以美國最為明顯，但其正向外溢效應也擴散至其他經濟體，尤其是亞洲國家。

未來幾年，電子零組件、電路板與半導體將佔該產業成長的極大比重。除了 AI 之外，加速數位化與工業自動化將是推動需求成長的主要因素。預期電子/ICT 產業將是中長期製造業中成長最快的產業之一。

隨著晶片製造商將產能轉向生產利潤更高的尖端 AI 晶片，全球傳統記憶體晶片的產能正逐漸縮減。供應短缺及隨之而來的價格上漲，對傳統記憶體晶片的採購商造成了損害，例如智慧型手機、個人電腦、消費性電子產品、電機設備與汽車的製造商。

這些產業的製造商只要支付高價，仍然可以取得記憶體晶片，但他們必須與投資 AI 領域的大型科技企業競爭，而這些企業通常擁有更充裕的財務資源。因此，他們若不是將較高的成本轉嫁給消費者而冒著需求下滑的風險，就是必須自行吸收成本而壓縮利潤空間；最有可能的情況是兩者兼具。儘管主要記憶體晶片製造商正在投資擴大產能，但新廠房至少需要幾年時間才能投入營運。

AI 過度投資仍是下行風險

未來可能的下行風險之一，是市場對 AI 效益的信心大幅下降。對於採用 AI 所帶來的生產力提升，各方估計差異甚大，從幅度有限到帶來轉型式的影響都有。這項技術在帶來明顯且可持續的成長方面，存在未如預期的風險。其他障礙也可能拖慢目前 AI 投資的快速步調。這些障礙包括：為取得所需的運算能力而必須投入鉅額資金、能源供應與法規造成的瓶頸，以及企業在組織重整方面所面臨的挑戰。

若科技業出現衰退，主要的拖累因素將來自於設備與軟體投資減少，以及股價下跌。在估算衰退情境時，我們的經濟學家預估，美國企業投資將下滑 9%，美股下跌 17%，亞股則將下跌 10% 至 30%。美國和亞洲的高科技企業將遭受重創，且對全球貿易成長的影響可能相當顯著（2027 年將下降1.5 個百分點）。

產業表現預測

歐洲				亞洲和大洋洲				美洲	
奧地利	荷蘭	澳洲	菲律賓	巴西	優 產業信用風險現況穩健/產業業務表現強於其長期趨勢。
比利時	波蘭	中國	新加坡	加拿大	好 產業信用風險現況看好/產業業務表現高於其長期趨勢。
捷克共和國	葡萄牙	香港	南韓	墨西哥	可 產業信用風險現況普通/產業業務表現穩定。
丹麥	斯洛伐克	印度	台灣	美國	差 產業信用風險現況相對偏高/產業業務表現低於其長期趨勢。
法國	西班牙	印尼	泰國		劣 產業信用風險不佳/產業業務表現弱於其長期趨勢。
德國	瑞典	日本	阿拉伯聯合大公國		
匈牙利	瑞士	馬來西亞	越南		
愛爾蘭	土耳其	紐西蘭			
義大利	英國				

產業趨勢

電子/ICT

電子與電腦產量	2025	2026*	2027*	2028*
全球	10.0	11.0	7.3	6.1
美洲	7.5	4.6	6.1	5.8
亞太	11.4	14.0	8.1	6.6
歐洲	3.7	2.1	3.4	3.3

年度同期比較，變化 % /*預測值
資料來源：Oxford Economics

各子產業的全球產量	2025	2026*	2027*	2028*
電腦和辦公用品	7.9	5.0	3.1	8.7
電子零組件/電路板	11.7	16.9	9.0	6.1
電信設備	15.2	6.5	9.3	7.4
消費電子產品	0.5	3.8	3.1	3.6

年度同期比較，變化 % /*預測值
資料來源：Oxford Economics

優勢與成長動力

高科技擴張。電子/ICT 是受科技驅動的創新產業。半導體細分市場的附加價值特別高，也能為製造商帶來相當穩健的利潤。

半導體擴大生產。這是在美國、歐盟和亞洲的策略目標。這三個地區最近通過了旨在支援國內生產成長的立法。

數位化、自動化、AI 與電動車的成長。數位化加速、工業自動化以及 AI 和電動車等新興市場對先進半導體的需求增加，都有助於推動 ICT 產業成為製造業成長速度最快的其中一個領域。

限制與下行風險

中美緊張局勢。貿易問題已經擴散到科技領域。川普和拜登政府皆已立法防止中國公司收購美國半導體製造技術和設備。中美雙方均將高科技領導地位視為戰略資產。中美若交惡，恐將給全球 ICT/電子供應鏈帶來負面影響。

「晶片民族主義」升溫。除了技術差異（例如在 5G 部署方面）之外，晶片民族主義還可能導致生產流程效率不彰及生產成本增加，影響產業生產力和獲利能力。



電子/ICT 展望

美洲

電子與電腦產量	2025	2026*	2027*	2028*
巴西	-5.4	-4.0	5.5	3.7
加拿大	4.5	3.6	1.1	1.4
墨西哥	3.0	-1.2	5.7	5.1
美國	8.2	5.5	6.2	6.0

年度同期比較，變化 % /*預測值 – 資料來源：Oxford Economics

產業表現預測

- 巴西
- 加拿大
- 墨西哥
- 美國

優
產業信用風險現況穩健/產業業務表現強於其長期趨勢。

好
產業信用風險現況看好/產業業務表現高於其長期趨勢。

可
產業信用風險現況普通/產業業務表現穩定。

差
產業信用風險現況相對偏高/產業業務表現低於其長期趨勢。

劣
產業信用風險不佳/產業業務表現弱於其長期趨勢。

美國

AI 熱潮持續帶動強勁成長

在美國，AI 熱潮在推動經濟成長方面扮演重要角色，帶動了製造業成長以及與 AI 投資相關的資本財進口，尤其是電腦產品。我們預期，美國電子/ICT 產值在 2026 年將成長 5.5%，2027 年則進一步成長 6.2%。

在資料中心、半導體製造、雲端基礎架構和電力網路方面的支出，已成為美國企業投資的主要動力。大型科技企業持續投入大量資源擴充 AI 能力，帶動營建、製造及專業商業服務等領域的需求。科技業對企業獲利成長及金融市場表現的貢獻也明顯高於其他產業。此外，越來越多美國企業開始正視雲端運算和儲存、資料處理自動化以及網路安全解決方案（例如主機代管服務），將這些視為優先要務。

美國不斷在增強其滿足國內對資料中心投資需求的能力。美國是全球最大的 AI 資料中心市場，其政府透過補貼或關稅威脅促使晶片製造產能回流國內的措施，似乎已取得一些成效。在 AI 資料中心投資需求的推動下，包括半導體在內的電子零組件與電路板子產業，仍是整體電子產品產值成長的最大貢獻者。我們預計此領域的產量今年將成長 8.9%，2027 年將成長 12.4%。

由於主要製造商投入大量資金，美國晶片產能在未來幾年有望持續提升。台積電在美國的總投資額預計將達 1,650 億美元，而三星電子與 SK 海力士也同樣在美國投入鉅資。

美國將繼續依賴晶片和伺服器進口

然而，儘管美國本土的晶片產能有所成長，但由於需求強勁，美國仍將高度依賴從亞洲和墨西哥進口伺服器與晶片。儘管我們預期美國在電子零組件與電路板的產量佔比將持續攀升，但其成長幅度仍將落後於中國、台灣與南韓。這使得美國在未來幾年內，仍需仰賴以亞洲為中心的國際科技供應鏈。

在 2025 年，電腦與辦公設備領域的產量增加了 14.6%。這是因為進入設備汰換週期，在疫情期間投資設備的個人與企業目前正尋求升級並汰換其技術設備。成長率將在 2026 年放緩至 1.0%，明年則為 1.8%。

近年來，由於寬頻基礎設施和 5G 行動系統升級，美國電信設備生產強勁成長。繼 2024 年大幅成長 16.1% 之後，2025 年的產量成長放緩至 3.6%，我們預期 2026 年將微幅成長 1.3%。

消費性電子、電腦與辦公設備等領域的利潤率普遍偏低，因此投入成本低廉至關重要。這將不利於推動將這些子產業的製造業務轉移回美國等高成本環境的措施。除了半導體領域外，要復甦美國的電子製造業，唯有透過國內勞工的技能再造與培訓（此舉成本高昂且耗時漫長），或是引進海外的低廉勞動力，才有可能實現。

電子/ICT 展望

亞太

電子與電腦產量	2025	2026*	2027*	2028*
中國	10.7	14.2	11.2	8.7
日本	2.4	2.4	3.9	4.9
南韓	8.8	12.7	5.1	3.5
台灣	33.7	29.8	6.0	3.5

年度同期比較，變化 % /*預測值 – 資料來源：Oxford Economics

產業表現預測
澳洲
中國
香港
印度
印尼
日本
馬來西亞
紐西蘭
菲律賓
新加坡
南韓
台灣
泰國
阿拉伯聯合大公國
越南

優
產業信用風險現況穩健/產業業務表現強於其長期趨勢。

好
產業信用風險現況看好/產業業務表現高於其長期趨勢。

可
產業信用風險現況普通/產業業務表現穩定。

差
產業信用風險現況相對偏高/產業業務表現低於其長期趨勢。

劣
產業信用風險不佳/產業業務表現弱於其長期趨勢。

中國

半導體生產帶動兩位數成長

中國生產全球半數以上的電子商品、電腦和電信設備，其產業狀況必然與全球需求密切相關。我們預期中國的電子和電腦產量成長率在 2026 年和 2027 年分別將達到 14.2% 和 11.2%。電子零組件與電路板子產業（包括半導體）將佔 2026 年整體成長的近四分之三，成長率達 23.5%。

高科技產業是政府重點產業策略的重要領域。北京當局長期以來一直強調晶片生產自給自足的重要性，並鼓勵國內對科技領域（如 AI、資料中心與大數據等）進行更多投資。鑑於美中科技脫鉤日益加劇，且北京當局堅決致力於達到科技自給自足，因此尖端晶片的生產在策略上具有高度的重要性。

中國不斷在拓展其供應鏈佈局，不僅涵蓋晶片製造，還涉及機械、材料和設計領域。即便先進晶片生產技術仍有進步空間，但中國似乎仍在向晶片製造價值鏈的上游攀升。近來，中國在 AI 高階晶片領域的技術發展迅速。但是，主要挑戰依然存在。中國仍面臨技術落差以及對外國設備的依賴，同時還受到尖端晶片與軟體進口限制的影響。這些阻礙可能會放緩其技術發展的步調。

中國在成熟製程晶片領域也大有進展，最近更擴展至記憶體晶片。南韓與美國的晶片製造商持續將生產重心轉向應用於 AI 資料中心的高頻寬記憶體晶片，因而為中國製造商在成熟製程記憶體晶片市場中創造了發展空間。

預計 2026 年電腦與辦公設備以及電信設備的產量將分別成長 0.3% 和 10.9%。雖然這兩個領域都可能受到記憶體晶片短缺的影響，但透過調整生產規格，減少晶片使用量或改用較低階的晶片，應可抵銷部分影響。

日本

AI 相關需求帶動高科技產品穩健成長

預期日本電子產品產值在 2026 年將成長 2.4%，2027 年則成長 3.9%。電子零組件與電路板是最大的子產業，佔電子產品總產值逾 60%，預計每年成長將超過 4.5%。日本在電子零組件與電路板生產方面的優勢，主要在電容器等零組件，而非尖端晶片或記憶體晶片。不過，這些高階零組件對 AI 資料中心而言至關重要，使得該國成為全球 AI 投資熱潮的主要受惠國之一。此外，日本計畫在未來幾年透過於 2022 年成立的半導體公司 Rapidus，擴大尖端晶片的本土生產。為此，日本政府已編列大筆資金。然而，AI 資料中心需求強勁導致邏輯晶片與記憶體晶片短缺，可能會對智慧型手機和個人電腦等其他電子產品的生產造成負面影響。



電子/ICT 展望

亞太

南韓

高階晶片生產的本土投資正如火如荼展開

南韓專精於生產記憶體晶片，因此受惠於 AI 相關資料中心對高階晶片的強勁需求。這點在全球兩家記憶體晶片製造巨頭 SK 海力士與三星電子身上尤其明顯。繼 2025 年增長 9.5% 之後，南韓的電子零組件與電路板產量預期在 2026 年成長 14.6%。

儘管部分晶片生產將為規避關稅而轉移至美國，但持續投資國內晶片廠將確保南韓在全球市場中繼續佔領重要地位。傳統上，由於記憶體晶片市場具備高度週期性，記憶體晶片製造商在需求旺盛時期向來對擴大投資抱持謹慎態度。這種情況已經改變，因為 AI 正在創造新的需求來源，而這股需求可能持續數年。政府致力於確保國家在先進半導體領域保持重要地位（例如透過支持培訓晶片設計專業人才的計畫），將進一步鞏固現有的技術優勢。

儘管南韓在全球高階記憶體晶片生產上仍保有龐大市佔率，但低階晶片生產正承受來自中國競爭者的壓力，其激烈的價格競爭促使價格持續走低。這可能會壓縮低階領域的獲利空間，但對更為重要的高階產品則影響有限。

台灣

2026 年產量再次呈現兩位數成長

繼去年產量大幅成長 33.7% 之後，預計今年台灣電子/ICT 產業的成長率將達到 30%。對尖端 AI 晶片的需求持續鞏固著極為強勁的產量成長，同時，伺服器、電腦及辦公設備領域的表現也十分亮眼，使出口訂單維持強勁表現。總部位於台灣的台積電是全球最大的晶圓代工廠，在高階晶片市場幾乎處於壟斷地位。面對美國的關稅威脅，該公司決定在美國投入鉅資，並在當地興建多座新的半導體晶圓廠。然而，從長遠來看，大多數高階晶片的生產很可能仍將留在台灣。



電子/ICT 展望

亞太

東南亞

未來幾年內，其在全球電子/ICT 產值中的佔比將持續攀升

東南亞國家持續鞏固其在全球電子/ICT 供應鏈中的角色，並擴大其在全球產值中的佔比。在美國關稅的壓力下，中國出口商紛紛透過轉口貿易或將生產據點轉移至第三國來尋求因應之道，同時貿易爭端再度升級的威脅依然揮之不去。隨著中國持續朝價值鏈上游發展，東協國家憑藉著勞動成本較低，吸引了更多電子產品等產業的製造產能。總而言之，該地區的電子/ICT 產業持續成長，而從事該產業的企業平均而言，信用風險狀況良好。

印尼

印尼的 ICT 產業成長強勁，主要表現在電子產品組裝、5G 電信設備升級及數位基礎架構等領域。雲端服務與消費性電子產品的需求日益增加，進一步推動產業成長，同時零組件產能也逐步擴大。在外國投資與東協外溢效應的支持下，該產業產量預計在 2026 年成長 9.5%、2027 年成長 6.7%，進一步鞏固印尼作為全球 ICT 供應鏈中極具競爭力樞紐的地位。

馬來西亞

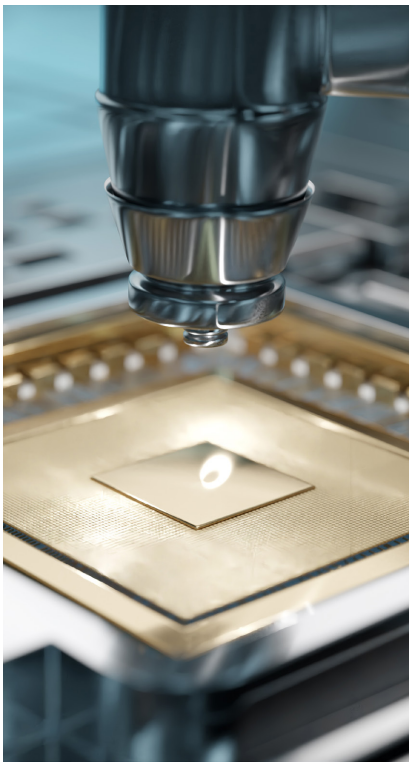
繼去年穩健成長 9.5% 後，我們預期馬來西亞電子產品產量的成長在 2026 年將加速至 11%。過去幾年裡，該國在晶片生產領域的重要性有所提升。政府推動的「國家半導體策略」(National Semiconductor Strategy) 等措施，以及其在晶片生產後段製程方面既有的優勢，吸引了全球高科技企業赴馬來西亞投資。鑑於晶片生產是美中貿易關係的關鍵癥結之一，馬來西亞有望受惠於產能自中國外移的潛在趨勢。

新加坡

新加坡的經濟持續受惠於穩健的電子產品出口；鑑於全球對 AI 的持續投資需求，我們預期這項趨勢將延續下去。事實上，新加坡電子產品產值預計在 2026 年將成長 11.3%。2025 年，新加坡佔全球電子零組件與電路板產值的 3.1%，相較於其在全球 GDP 僅佔 0.1% 而言，這個比重相當可觀。新加坡在該區域的資料中心產能中，依然保有最高價值與頂級的市場地位。

越南

越南處於有利地位，可承接企業為分散對中國的依賴而產生的需求。越南與中國供應鏈緊密相連，極有可能受惠於中國以出口為導向的製造業擴張所帶來的外溢效應。過去 15 年來，電子產品組裝與零組件製造業迅速擴大規模。該國正逐步朝價值鏈上游發展，進軍半導體與印刷電路板生產領域。越南是消費性電子產品的主要生產國，該產業自 2010 年以來已成長逾十倍。目前，越南電子/ICT 產品出口持續表現優異，這得益於在當前 AI 熱潮下，越南在電子產品供應鏈中的重要地位。



電子/ICT 展望
歐洲

電子與電腦產量	2025	2026*	2027*	2028*
法國	1.8	0.7	1.0	1.3
德國	1.0	-0.2	9.5	5.8
義大利	3.1	1.7	1.0	2.0
英國	2.4	2.3	-0.7	2.0

年度同期比較，變化 % /*預測值 – 資料來源：Oxford Economics

歐洲

受到工業投資疲軟影響，2026 年成長溫和

相較於亞太地區和美國的成長率，歐洲電子/ICT 產業持續表現不佳。繼 2024 年萎縮 0.7% 及 2025 年反彈 2.9% 後，我們預期歐盟與英國的電子產品及電腦產值成長將在 2026 年放緩至 2.1%。儘管數位化、物聯網 (IoT) 以及 AI 等技術的結構性需求將支持該產業，但仍無法避開歐洲經濟成長放緩的影響。該地區的半導體生產主要集中於工業用途的功率晶片，而非尖端 AI 應用所需的晶片。這導致該產業容易受到該地區工業需求疲軟的影響。整體宏觀經濟投資活動疲弱（預期今年僅成長 0.9%），將對資本密集型的精密及光學儀器子產業造成壓力，而該子產業是歐洲最大的電子產品產業。預計該產業產值今年僅成長 1.5%。

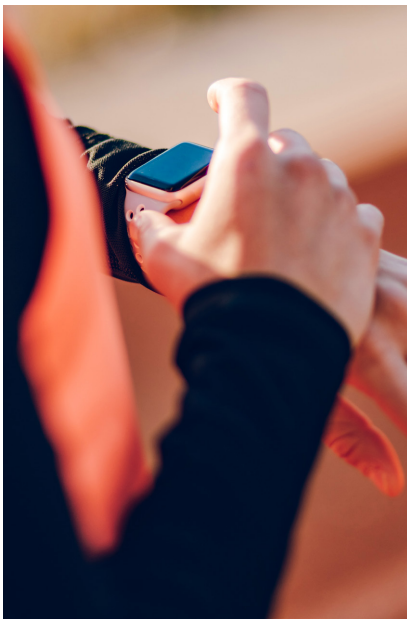
2027 年強勁反彈

我們預期 2027 年電子產品及電腦產值將強勁成長 4.4%，主要原因是該地區的國防支出增加。德國的情況尤其明顯，當地財政規則的調整為擴大支出提供了空間。鑑於國防設備將需要用到電子零組件，歐盟電子零組件與電路板子產業將成為主要受益者。預計該領域將成長 6.9%。精密設備子產業也將受惠，預計成長 5%，其中包括 GPS 裝置、雷達設備及飛機引擎儀表等產品。整體而言，技術進步所帶來的結構性需求，將在未來幾年為該產業提供助力。

半導體生產的重大投資正在進行中，但缺乏對高階晶片的重視

與東亞國家及美國一樣，歐盟也已經通過相關法案，支持當地半導體產業。《歐盟晶片法案》(EU Chips Act) 預計將投資 430 億歐元，用於本地半導體生產和研究，目標是要降低對亞洲進口的依賴，並在 2030 年之前達到 20% 的全球晶片生產市佔率。

然而，目前的估計顯示，歐盟在 2030 年達到全球半導體產能 20% 的目標可能難以實現，原因在於，相較於美國，歐盟的補貼受到限制；而相較於東亞，歐盟也存在地理位置上的劣勢（例如營運成本及勞動成本）。歐盟持續將重點放在工業晶片與車用晶片，而非資料中心所使用的高階晶片，這項策略與其經濟結構相符。生產高階半導體的技術壁壘極高，該地區必須在確保技術自主與善用先進外國技術之間審慎拿捏。



產業表現預測
奧地利
比利時
捷克共和國
丹麥
法國
德國
匈牙利
愛爾蘭
義大利
荷蘭
波蘭
葡萄牙
斯洛伐克
西班牙
瑞典
瑞士
土耳其
英國

優
產業信用風險現況穩健/產業業務表現強於其長期趨勢。

好
產業信用風險現況看好/產業業務表現高於其長期趨勢。

可
產業信用風險現況普通/產業業務表現穩定。

差
產業信用風險現況相對偏高/產業業務表現低於其長期趨勢。

劣
產業信用風險不佳/產業業務表現弱於其長期趨勢。

您想深入瞭解更多資訊嗎？

請上網瀏覽 Atradius 網站，查閱更多最新出版品。按一下這裡可以瀏覽我們針對各產業表現進行的分析，我們的分析十分詳盡，內容著重於各國家/地區與全球經濟重要議題、信用管理問題相關洞見，以及保障應收帳款、防範客戶付款違約的相關資訊。



Kyle Kong
Atradius 資深信用風險分析師，台灣。
全球及北亞電子和 ICT 產業專家。



Ricky Suwandi
Atradius 資深核保副理，印尼雅加達。
東南亞電子和 ICT 產業專家。

追蹤 Atradius 社群媒體

youtube.com/user/atradiusgroup
linkedin.com/company/atradius

版權所有 Atradius N.V. 2026
免責聲明：本刊物僅供參考之用，並不構成任何保險產品的銷售、投資建議或法律建議，亦不代表以任何方式對任何讀者就特定交易、保險產品、投資或策略提出推薦或建議。讀者參酌本文提供之資訊時，無論應用於商業或其他用途，務請自行獨立判斷決定，並在適用情況下閱讀其保險保單條款。

Atradius 已盡全力確保本刊物所含資訊來自可靠來源，但不論是任何錯誤或疏漏，或因使用本報告所載資訊而得到的結果，Atradius 概不負責。本刊物內所有的資訊均按「原樣」提供，不保證其完整性、準確性、時效性，或因使用此份報告而得到的結果，亦不提供任何形式的明示或暗示保證。

Atradius 及其相關合夥人或合作企業，或其合作夥伴、代理商或員工，不為您或其他任何人因採用本刊物所載資訊而進行之任何決定或行動，或任何商機損失、利潤損失、生產損失、業務損失或間接損失、任何種類的特別或類似之損害負責，無論事前是否得知會有此類損失或損害之可能。

Atradius
David Ricardostraat 1
1066 JS Amsterdam
P.O. box 8982
1006 JD Amsterdam
The Netherlands
電話：+31 (0)20 - 553 91 11

info@atradius.com
www.atradius.com